

强一半导体（苏州）股份有限公司

关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订《投资协议书（三）》暨对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资事项概述

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会（以下简称“苏锡通管委会”）于2023年3月21日就半导体产品、集成电路测试探针卡、集成电路陶瓷基板及器件等产品的研发、生产和销售项目签订《投资协议书》（以下简称“原投资协议”）和《投资补充协议》，并在苏锡通科技产业园区设立全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“项目公司”）实施整个项目的投资、建设和运营。该项目分为一期和二期，为优化资源配置，公司于2025年12月10日召开了第二届董事会第五次会议、于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与苏锡通管委会签署〈投资协议书（二）〉的议案》，同意公司将原投资协议约定的二期项目分成2-1、2-2期逐步推进实施，并与苏锡通管委会就投资建设2-1期项目签订《投资协议书（二）》。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议书（二）暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-011）。

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）南通探针卡研发及生产项目为上述一期项目的构成主体。公司在南通探针卡研发及生产项目实施过程中，

基于对产品品质稳定性、生产一致性及运营效率的综合考量，对原规划的手动及半自动生产线方案进行了系统性升级，拟建设以全自动化生产设备为核心的先进制造体系。与此同时，全自动生产线及智能物流系统的引入，对厂房在空间布局、层高承载、结构强度、电力容量、洁净环境、信息化接口及安全冗余设计等方面提出了更高要求，为保障自动化设备稳定运行及系统集成效果，公司需在原有规划基础上，对厂房结构、机电系统及相关配套进行同步强化建设。公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第六次会议、于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》，同意实施主体增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，南通探针卡研发及生产项目投资总额将由人民币 120,000.00 万元增加至人民币 246,770.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-008）。

二、本次对外投资事项进展

基于南通探针卡研发及生产项目投资额度的调整，近期公司与苏锡通管委会达成一致，同意将项目公司注册资本由原投资协议约定的 5 亿元增加至 6 亿元，并补充签订《投资协议书（三）》，本事项已经公司总经理办公会议审议通过。协议主要内容如下：

（一）协议各方

甲方：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会

乙方：强一半导体（苏州）股份有限公司

（二）投资项目基本情况

1、项目内容：半导体产品、集成电路探针卡及器件等产品的研发、生产和销售（以下简称“本项目”）。

2、项目投资：总投资 10 亿元，其中设备投资约 4 亿元。乙方承诺，将项目公司注册资本增加至 6 亿元，并在项目公司领取新的营业执照之日起 5 年内到账。

（注：上述“总投资 10 亿元”为基于原投资协议约定的“一期总投资约 10 亿元”基础上的新增投资额。）

3、项目进程：本项目计划使用原一期厂房载体，乙方承诺于 2027 年 12 月前竣工投产。

（三）双方的主要权利和义务

1、甲方为乙方投资提供“一站式服务”，协助乙方办理公司变更、项目审批、规划建设等方面的相关证照。以上证照的办理完毕时间应与乙方项目实施进度相一致，不因此影响乙方项目实施和乙方的生产经营。但乙方及项目公司应在甲方要求的合理时间内提供为办理相关手续所需要的相关文件数据。

2、甲方将根据相关政策文件精神，为项目公司在满足相关条件时积极向上争取中央、省、市、区级各类专项扶持政策提供支持及协助（各类扶持政策的审核标准及兑现流程等以最新政策文件为准）。

3、若无正当理由，乙方必须按本协议约定的时间、条件完成实缴注册资本、开工及竣工投产等义务。

4、乙方投资的项目须符合园区的总体规划、产业定位和环保要求。

5、如乙方迁出苏锡通科技产业园区，乙方应当在向迁入地登记部门申请迁入之前 30 个工作日将迁出事宜书面告知甲方。

（四）违约责任及争议的解决

1、本协议除了法定或本协议约定原因外，非经双方协商一致不得单方解除。任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任并赔偿对方经济损失。如乙方或项目公司对本协议中关于该项目所承诺的事项（包括但不限于投资规模，增资、到

账、开工、竣工及投产时间等事项）未履行或全部履行的，则甲方与乙方及项目公司应就未履行事项另行协商。

2、双方因本协议的履行、解释而发生争议，如不能协商解决，则提请南通仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则仲裁解决。

（五）其他约定

1、本协议经甲乙双方盖章及甲乙双方合法授权人签字生效。

2、本协议与双方于 2023 年 3 月 21 日签署的《投资协议书》及《投资补充协议》，以及 2026 年 2 月 2 日签署的《投资协议书二》共同组成完整的协议，为双方主张权利义务的合同依据，具有同等法律效力。如有内容不一致的，以本协议内容为准或双方另行协商确定。

三、对公司的影响

本次协议的签署主要基于前期南通探针卡研发及生产项目投资额度的调整，符合公司的发展战略和整体经营规划。由于项目建设具有一定周期，对公司财务状况的具体影响将根据工程实施进度及实际支付、结算情况逐步体现，预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）项目审批与合规风险

项目建设需取得建设项目核准或备案、环境影响评价、节能评估、安全生产评价报告等资质。若上述审批流程受阻，或相关资质无法顺利获取，项目实施进度将面临不确定性，存在延期或停滞的风险。

（二）外部环境 with 项目调整风险

项目投资与建设将受国家产业政策、市场供需、行业竞争及技术进步等多重因素影响，可能导致投资金额和建设内容调整。

（三）资金筹措与偿债风险

项目投资金额较大，公司将分阶段投入资金，并已规划通过募集资金（含超募资金）、自有资金及自筹资金等渠道解决资金需求。虽已充分考虑资金筹措方案，但存在资金到位不及时的风险。如通过银行贷款筹资，而项目若未达预期经济效益，公司将面临一定的偿债压力。

公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日